



*HM6610MR 快充识别模块使用说明:
1. 按DC芯片FB脚基准电压设置合适的RH/RL1/RL2使DC芯片正常输出5V。
2. VBUS接DC芯片输出端,GND接地, REF接到DC芯片的FB脚,按需要设置AP端电平,之后在USB端接近手机即可。

以下以FB脚提高到2.5V为例:(默认电压以5V计算)
1. 电阻比RH/(RL1+RL2)=1倍,即1/2分压比,比如RH用100K, RL1+RL2=100K时, $V_{FB}=5V \times 100/(100+100)=2.5V$
2. 根据DC芯片FB基准电压确定RL1和RL2值:
假设DC芯片FB基准是0.5V,那么相当是RL1/RL1分压2.5V取出0.5V,分压比是0.5V/2.5V=1/5,因为RL1+RL2=100K,所以RL2=100K*1/5=20K,那么RL1=100K-20K=80K。

*说明:BP/AP短接时启动QC快充功能;AP与地短接时关闭QC快充功能。
设计说明:设置RH/RL1/RL2时必须保证HM6610MR的FB脚大于1.2V,为提高兼容性建议提高到2V-2.5V
*以上RH/RL1/RL2值是按DC芯片FB脚基准0.5V计算的,其他REF电压需要重新设置RH/RL1/RL2

Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	11-Sep-2018	Sheet	of
File:	G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	